

17:30 Uhr

Gemeinsames Abendessen / Get-together

## Tagesprogramm für den 17. Februar 2016

Tagesprogramm für den 17. Februar 2016		
ab 09:00 Uhr	Registrierung	
10:00 Uhr	Begrüßungstalk mit:	
	Thomas Albiez, Hauptgeschäftsführer der IHK-Schwarzwald-Baar-Heuberg  Bernhard Kaiser, Bürgermeister der Stadt Donaueschingen  Dr. Harald Stallforth, Vorstandsvorsitzender des TechnologyMountains e. V.	
	<b>Uwe Remer</b> , geschäftsführender Gesellschafter der 2E mechatronic GmbH & Co. KG <b>Prof. DrIng. Roland Zengerle</b> , Institutsleiter der Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte Forschung e. V. Freiburg	
10:30 Uhr	Keynotes  HoloLens – Augmented Reality? Virtual Reality? go beyond with MixedReality Lars Knoke, Architect Strategy & Innovation, Microsoft Deutschland GmbH & Jens Kottsieper,	
	Technical Solution Specialist, Microsoft Deutschland GmbH  Die (Service-)Roboter von morgen – aus den Fabrikhallen in den Alltag Dr. Ulrich Reiser,	
	Projekt- und Gruppenleiter Roboter- und Assistenzsysteme, Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA	
12:00 Uhr	Mittagessen / Diskussion mit den Experten / Fachausstellung / B2B-Gespräche	
13:00 Uhr	Precission Technologies & Prototyping	Smart Components
	Kontinuierlicher 3D-Druck für die Serienfertigung Claus Aumund-Kopp, Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM	Hochintegrierte Stromsensoren für Leistungselektronik mit hoher Leistungsdichte in der Elektromobilität Dr. Rolf Slatter, Sensitec GmbH
	<b>Zwei-Photonen-Polymerisation auf Wafer-Level-Scale</b> Eric Markweg, TETRA Gesellschaft für Sensorik, Robotik und Automation mbH	Multi-axial force measurement with optics Ákos Dömötör, OptoForce Ltd.
	Verbindungstechnologien für die 3D Montage - Eine Evaluierungsstudie Sascha Lohse, Finetech GmbH & Co. KG	RFID als eine Kommunikationsplattform im Internet of Things Reinhard Jurisch, Micro-Sensys GmbH
	Industrial production of micro parts by Micro Laser Sintering Matthias Winderlich, 3D MicroPrint GmbH	Aus Wärme Strom erzeugen - Die nachhaltige Stromversorgung für das Internet of Things Frederick Lessmann, otego spin-off project, Karlsruher Institut für Technologie KIT
14:00 Uhr	Kaffeepause / Diskussion mit den Experten / Fachausstellung / B2B-Gespräche	
15:00 Uhr	Precission Manufacturing & Assembly	Smart Systems
	Smart Adhesives for highly automated Active Alignment processes Maximilian Baum, DELO Industrie Klebstoffe GmbH und Co. KGaA	VIP – Vision in a Package Dr. Christiane Gimkiewicz, Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique CSEM SA
	Planung und Inbetriebnahme sensorgeführter Mikromontageprozesse effizient gestalten Sebastian Haag, Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT	Sichere und durchgängige Kommunikationslösungen für Industrie 4.0 Prof. DrIng. Axel Sikora, Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte Forschung e. V.
	UV-Laser und Strahlsysteme zur flächigen Bearbeitung in der Display- Industrie DrIng. Oliver Haupt, Coherent LaserSystems GmbH & Co. KG	Funkbasiertes MDE-System zum Nachrüsten Michael Wigant, WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG
	Mit neuen innovativen Technologien zu neuen Komponenten für einen komplexen Mikrosensor zum kontinuierlichen Glukosemonitoring Dr. Hans-Joachim Freitag, CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik	Power-by-Light: An Innovative Power Supply Solution for Smart Systems Dr. Henning Helmers, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE
	GmbH	
16:00 Uhr	Kaffeepause / Diskussion mit den Experten / Fachausstellung / B2B-Gespräche	
16:30 Uhr	Embedded Technologies & Measurement	Innovation Management & Cooperation
	<b>Die Leichtigkeit des taktilen Messens</b> Bernhard Lichtenauer, DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH	Paradox Mittelstandsinnovation Marin Baraba & Bodo Henkel, Dekadi Baraba & Henkel Innovation Consultants PartG
	Kombinierte Druck- und Näherungssensorik Dr. Bernhard Brunner, Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC	OurPlant. The Prime Micro Assembly Platform. Uwe Schulz, Häcker Automation GmbH
	<b>Zerstörungsfreies Prüfen mittels Infrarot-Thermografie</b> Peter Nicolaus, InfraTec GmbH	Prozesse werden zu Apps - Wie Sie Anwendungen einfach mobilisieren Jens Vanicek, ALL4NET GmbH
	MID - Intelligente AVT im 3D-Format Uwe Remer, 2E mechatronic GmbH & Co. KG	Verbundprojekte als Erfolgsfaktor für Smarte Kunststoffprodukte Siegfried Kaiser, Kunststoff-Institut Südwest GmbH & Co. KG